



平成 27年 4月 吉日

お取引先様各位

テイシン電機株式会社  
本社営業部



クリップ絶縁カバー(塩ビ)可塑剤変更のお知らせ  
<改正RoHS(RoHS2)対応>

謹啓

貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のお引き立てにあずかり、厚く御礼申し上げます。

さて、最近になり改正RoHSの問題が騒がれてきており、その対象規制物質とれているのが、当社クリップの絶縁カバーの可塑剤として使用されている<DEHP(フタル酸ビス-2エチルヘキシル)>です。そこで当社でもようやく一部の製品を対象に準備が整いましたので、ご報告申し上げます。製品につきましては、使用上何の変更もございませんので、納入LOTでは分けはするものの、自然切替えとさせていただきますこと、ご理解願います。

尚、当社の環境管理上<平成27年6月~>の納入品より、対応品供給開始とさせていただきます事、ご理解願います。それに伴い、環境回答におきましても、6月以降のご依頼分からの回答とさせていただきます。何卒、ご理解ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

謹白

## 記

対象品番

C-101 R,B,G,Y,W,BL

C-102 R,B,G,Y,W,BL

C-103 R,B,G,Y,BL \*W(白)を除く

C-511S R,B

C-631 R,B

C-681 R,B

変更材質

DINP

フタル酸ジイソニノル

Cas, 28553-12-0

C-106-1A R,B,G,Y,W,BL

C-521S R,B

C-661R,B

DOTP

テレフタル酸ビス-2エチルヘキシル

Cas, 6422-86-2

\*対象外品番:C-104・C-104S・C-123・C-501S・C-531S

以上